**证券代码：605358**  **证券简称：立昂微**

**杭州立昂微电子股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ●特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □新闻发布会  □现场参观 □电话会议  □其他 |
| 参与单位名称 | 国联民生证券、东北证券、华鑫证券、山西证券、野村东方国际证券、汇丰晋信基金、泰康资产、勤辰资产、翊安投资、远海私募等12人 |
| 时间 | 2024年4月29日 15：00 |
| 地点 | 现场交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云 |
| 投资者关系活动记录 | 一、公司概况  公司对2024年年度及2025年第一季度业绩变化情况进行了说明，并对各业务板块的经营情况进行了介绍（部分摘要）：  （一）硅片业务板块  1.产能（截至2024年末）：6英寸抛光片（含衬底片）产能60万片/月、8英寸抛光片（含衬底片）产能57万片/月、6-8英寸（兼容）外延片产能82万片/月；衢州基地12英寸抛光片（含衬底片）产能15万片/月、12英寸外延片产能10万片/月；嘉兴基地12英寸抛光片产能15万片/月。  2.产能利用率：  （1）6-8英寸外延片产能自2024年第二季度至今产能利用饱满，其中8英寸订单目前处于供不应求。主要原因：1.市场对厚外延片的需求较高；2.金瑞泓在重掺工艺的技术领先，具有较高产品竞争力；3.受美国关税政策影响，进口替代加快。  （2）12英寸硅片稼动率2024年取得较大提升，目前正处于产能爬坡过程中。  （二）功率器件芯片业务板块  1.产能及产能利用率情况  目前设备产能约为23.5万片/月，2024年功率器件芯片销量182.40万片，较2023年同期增长6.30%，目前稳定月产出约17-18万片。2024年产品价格受光伏市场等因素的影响有所下降，毛利率有所降低。  2.应用：公司积极调整产品结构，沟槽SBD产品占比提升；汽车电子芯片和FRD芯片供应国内比亚迪及某重要客户；今后将重点发展汽车电子芯片、FRD芯片等，进一步优化产品结构。  （三）化合物半导体射频芯片  1.产能：杭州基地9万片/年；海宁基地6万片/年（已通线、正在调试和验证）。  2.产品种类：1.手机功率放大器芯片，通过昂瑞微、唯捷创芯、锐石创芯等客户供应手机终端客户；2.航空航天等特殊用途芯片，宇航级射频芯片已实现低轨卫星终端规模化交付；3.VCSEL芯片，公司二维可寻址大功率VCSEL工艺技术，成为全球首家量产车规级激光雷达VCSEL芯片的制造商，最新月出货约400片，后续会进一步提升。产品已应用于智能驾驶与机器人领域，在汽车补盲雷达中有较高的用途，在机器人、人脸识别、光通信等领域也会有较大的用途；4.碳化硅基氮化镓芯片，公司开发的国内第一款6英寸0.45微米的碳化硅基氮化镓（GaN HEMT）工艺技术取得重要进展，技术指标对标或超过竞品，6英寸0.25微米的GaN HEMT工艺技术也在加紧开发中。  3.具备技术：技术与国际头部同行处于同一梯队，客户已大范围覆盖，打破海外厂商垄断格局，确立国产替代领军地位。  未来发展聚焦于：1.12英寸硅片的产能爬坡。2.海宁基地化合物半导体射频芯片的验证和快速上量。3.功率半导体产品结构优化，进一步提升汽车电子、FRD芯片等高附加值产品；同时探索产品迭代，在现有功率产线设备的基础上增加少量瓶颈设备，实现功率产品的代际升级。  二、投资者交流主要问题回复  1.公司 6-8英寸外延片兼容，其中6英寸和8英寸各占多少比例？  答：2024年底，6-8英寸（兼容）外延片产能82万片/月，从设备端来讲，6-8英寸产品可实现共享，具体比例根据客户订单需求及产品结构动态调整。  2.公司12英寸大硅片基地中是否嘉兴全部是轻掺片、衢州全是重掺片？  答：公司嘉兴基地15万片/月的产能全部是轻掺抛光片、衢州基地15万片/月的产能中10万片/月为重掺片，另有5万片轻掺片产能。  3.公司2022年收购嘉兴基地（原国晶半导体）是基于什么考虑？  答：基于如下考虑：1.快速扩大轻掺抛光片产能。原国晶半导体规划建设40万片/月的轻掺抛光片产能，其中首期建设15万片/月的产能，收购时嘉兴公司厂房和自动化设施已经建成且已有部分设备到位，收购后可以快速提升公司的轻掺产能；2.实现技术优势互补。嘉兴基地的技术团队源自德国世创（新加坡）12英寸抛光片工厂，具备较强的轻掺技术实力；3.采用高标准建设。嘉兴基地当前是国内全自动化程度最高、智能化程度最高的12英寸硅片工厂。4.收购成本可控。基于建设成本加财务费用的价格进行收购，收购成本合理可控。  4.公司2025年还会大量新增折旧费用么？  答：公司2025年新增资本性开支不多。预计2025年新增的折旧主要是衢州20万片/月8英寸外延片项目以及海宁立昂东芯6万片/年的化合物半导体射频芯片项目届时转产增加的折旧。  5.据传受美国关税政策的影响，部分客户的外延片需求将从美国转向国内，请问客户国产替代的决心和紧迫性如何？  答：半导体产品的国产化替代是一个趋势，不可逆转。重掺硅片属于公司的拳头产品，在国内外拥有较强的市场竞争力，公司将充分发挥产品的技术优势，抓住市场机遇，不断提升市场份额。  6.如何看待当前12英寸硅片产品的价格水平？  答：当前国内12英寸硅片产品的价格已处于低位，且低于国外同类产品的价格水平，预计12英寸硅片产品的价格有望合理回升，回归合理的价格水平。 |
| 资料清单（如有） | 无 |